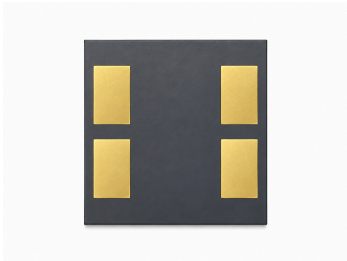


2 × 20 Ω Die resistor de filme fino GaAs

Resistência: 20 / 20 Ω (típico); Corrente de operação linear: 0.165 / 0.165 A (típico);  
Corrente máxima admissível: 0.33 A (máximo). Dimensões do die em planta: 0.5 × 0.5 mm.



Características elétricas · TA = +25 °C

| Parâmetro                   | Símbolo | Mínimo | Típico        | Máximo | Valor | Unidade |
|-----------------------------|---------|--------|---------------|--------|-------|---------|
| Número de resistores        | -       | -      | -             | -      | 2     | -       |
| Número de terminais         | -       | -      | -             | -      | 4     | -       |
| Resistência                 | -       | -      | 20 / 20       | -      | -     | Ω       |
| Tolerância da resistência   | -       | -      | ±5            | -      | -     | %       |
| Corrente de operação linear | -       | -      | 0.165 / 0.165 | -      | -     | A       |

Valores limite

| Parâmetro                  | Símbolo | Mínimo | Típico | Máximo | Unidade |
|----------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| Corrente máxima admissível | -       | -      | -      | 0.33   | A       |

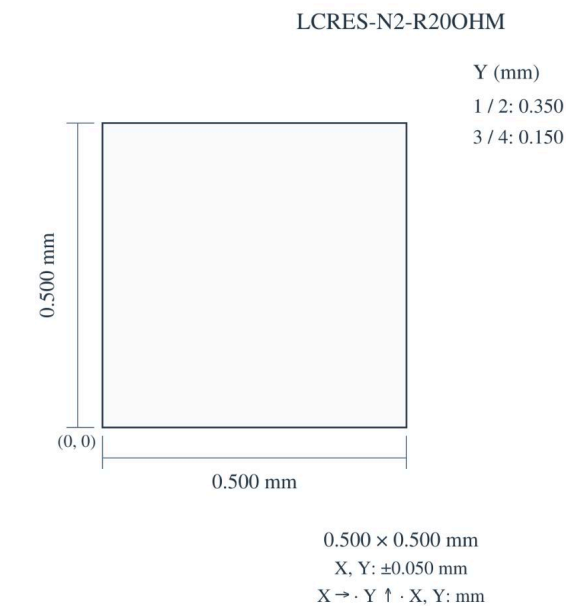
Condições ambientais

| Parâmetro                    | Símbolo | Mínimo | Típico | Máximo | Unidade |
|------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| Temperatura de armazenamento | -       | -65    | -      | 150    | °C      |
| Temperatura de operação      | -       | -55    | -      | 125    | °C      |

Dimensões do die

| Parâmetro                  | Valor     | Unidade |
|----------------------------|-----------|---------|
| Dimensões do die em planta | 0.5 × 0.5 | mm      |

Desenho dimensional mecânico



Todas as dimensões estão em mm [in].

Atribuição dos pads de ligação

| Terminais              | Símbolo  | Função                  | Observações |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------|
| 1, 2                   | IN1/OUT1 | Entrada/saída recíproca | 1           |
| 3, 4                   | IN2/OUT2 | Entrada/saída recíproca | 2           |
| Face posterior do chip | GND      | Terra                   | RF / DC GND |

Registro da publicação atual · 1.1 · 2026-10-23. Atualização das tabelas de especificações. Substitui a revisão 1.0.

Integração do die e sequência de polarização

A face posterior do die requer uma ligação à terra confiável.

Escopo da referência mecânica

Referência dimensional em mm baseada na documentação de origem. Informações parciais; não constitui um desenho completo de fabricação ou de ligação por fios.

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.